

### ANEXO I Relación de persoa/s superaron o Terceiro Exercicio

Nome	Puntuación
<b>Pazos Álvarez, Antonio</b>	<b>35 puntos</b>

APARTADO	EXERCICIO Terceiro	PUNTUACIÓN (total máximo 35 puntos)
<b>PARTE 1 Montaxe dunha Placa de Circuito Impreso (max 18 puntos)</b>		
a	Aplicación da pasta de soldadura nunha Placa de Circuito Impreso ( 6 puntos )	6
b	Ausencia de cortocircuitos nos contactos dos conectores ( 6 puntos )	6
c	Continuidade entre conectores ( 6 puntos)	6
	Fotografía/s do resultado final para arquivo	
SUMA PARCIAL		18
<b>PARTE 2 Micro-soldadura con equipo manual Ball-Bonding (max 17 puntos)</b>		
a	Realizáranse a micro-soldadura de 4 fíos dende o cadrado central a 4 bonding pads que o rodean (7 puntos)	7
b	Realizárase sobre algún dos catro fíos a proba destrutiva de resistencia de forza co dinamómetro de precisión (Pull-tester) que supere os 2 gramos ( 5 puntos )	5
c	Realizárase sobre algún dos catro fíos a proba destrutiva de resistencia de forza co dinamómetro de precisión (Pull-tester) que supere os 6 gramos (5 puntos)	5
	Fotografía/s do resultado final para arquivo	
SUMA PARCIAL		17
SUMA TOTAL (mínimo 15 puntos)		<b>35</b>

Documento asinado dixitalmente conforme a Lei 39/2015 do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE nº 236 do 2 de outubro de 2015).